

IBM、三星等五大厂携手开发32nm半导体生产技术 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/232/2021_2022_IBM_E3_80_81_E4_B8_89_E6_c41_232609.htm 美国IBM、韩国三星电子、德国Infineon等五大厂日前宣布，将携手合作、共同开发采用32nm制程的新世代半导体生产技术。产品将以系统LSI等非记忆体半导体为主要应用领域，开发作业预定于2010年完成。参与该项计划的厂商表示，希望透过共同开发降低研发成本、提升产品竞争力。除上述三家厂商外，参与该项计划的成员还包括新加坡特许半导体与美商半导体业者Freescale.透过共同开发之技术共享，除可降低研发成本外，还可互通彼此的产品。IBM与三星在65nm与45nm制程技术方面，都具有合作关系。最先进的45nm制程产品，最快将于今年下半年量产。由于共同开发效益颇佳，双方因而决定将合作关系延续至新世代的32nm制程技术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com